公司代码:688126　　公司简称:沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

3　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年4月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,2019年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

7　是否在公司治理特殊安排等重要事项

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李炜	王艳
办公地址	上海市长宁路865号5楼4楼	上海市长宁路865号5楼4楼
电话	021-52589038	021-52589038
电子信箱	pr@shi-negi.com	pr@shi-negi.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)　主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务基本情况

上海硅产业集团主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,也是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化生产和销售的企业。自设立以来,坚持面向国家半导体行业的重大战略需求,坚持全球化布局,坚持紧密国际前沿技术,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,打破了我国300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料,目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造,是半导体产业链基础性的一环。然而,半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一,当前我国半导体硅片的供应高度依赖进口,国产化进程严重滞后。经过持续的努力,上海硅产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了台积电、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微等芯片制造企业。公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

2、主要产品

上海硅产业集团主要产品为300mm及以下的半导体硅片。公司产品终端应用涵盖移动通信、便携式设备、汽车电子、物联网、工业电子等多个行业。

200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)主要应用于传感器、射频前端芯片、模拟芯片、功率器件、分立器件等领域。子公司Okmetic、新傲科技在面向射频芯片、模拟芯片、先进传感器、汽车电子等高端细分市场应用具有一定的优势,与多家客户保持了十年以上的深度、稳定的合作关系。特别是在SOI硅片方面,公司掌握了SIMOX、Bonding、Simbond、Smart CutTM等先进的SOI硅片制造技术,可以提供多种类型的SOI硅片产品。

300mm半导体硅片主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件等领域。根据SEMI统计,2019年,全球300mm半导体硅片出货面积占全部半导体硅片出货面积的67.22%,是市场上最为主流的半导体硅片类型。由于半导体硅片的生产工艺与技术难度随硅片尺寸的增大而提高,全球范围内仅少数半导体硅片龙头企业掌握300mm半导体硅片的生产技术。子公司上海新昇于2018年实现了300mm半导体硅片的规模化生产,填补了中国大陆300mm半导体硅片产业化的空白,2019年300mm半导体硅片产能从2018年的10万片/月进一步提升至15万片/月,生产规模持续扩大。

(二)　主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片实现收入和利润。

2、采购模式

为保证产品的质量和性能,公司制定了严格的供应商选择和审核制度。达到经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等众多标准要求的供应商,才可以被考虑纳入公司合格供应商名录,并定期审核。目前,公司已经与全球众多供应商建立了长期、稳定的合作关系。

3、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式,大部分产品按订单批量生产,同时进行少量备货式生产。在生产方面,公司建立了生产管理制度,对生产过程中的各个因素进行控制,合理安排生产,协调各项生产活动,确保产品质量及交付满足规定的要求和客户的需求。在自主生产为主的同时,公司结合市场情况和目身产能利用情况,在部分非关键性技术生产环节适当配以外协加工进行辅助,以最大化满足市场需求。

4、销售模式

报告期内,公司全部产品均通过直销模式销售。由于半导体硅片的行业壁垒较高,生产企业和主要下游客户较为集中,公司通常采取主动开发潜在客户并与客户直接谈判的方式获取订单。同时,公司也通过少量代理商协助开展中小客户的接洽工作。通常,代理商接洽的客户,公司直接向客户发货销售,向代理商支付销售佣金。报告期内,公司300mm半导体硅片全部通过直接与客户谈判的方式实现销售,仅200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)存在部分销售通过代理商进行的情况。

(三)　所处行业情况

1、　行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展的阶段

半导体硅片作为芯片制造的关键材料,市场高度集中,近年来,全球前五大半导体硅片厂的市场占有率为90%以上,呈现寡头垄断格局。中国大陆的半导体硅片企业主要生产150mm及以下的半导体硅片,仅有少数几家企业具有200mm半导体硅片的生产能力。2017年及以前,国内300mm半导体硅片几乎全部依赖进口。2018年,上海新昇作为中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化生产和销售的企业,打破了300mm半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。

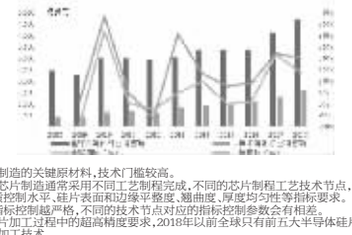
(2)行业发展的基本特点

半导体行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势,半导体硅片行业的市场波动基本同步于整个半导体行业的波动周期。

2008年至2018年,全球半导体行业销售额从2,486.03亿美元增长至4,687.78亿美元,十年年均复合增长率6.55%,全球半导体行业市场规模不断扩大,总体呈波动上升趋势,与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。

半导体行业通常在经历1-2年的增长周期后,会步入平整和回落周期,经过1-2年的技术迭代、产品结构调整和库存调整,再进入新一轮增长周期。

2008~2018年间全球与中国半导体行业销售额统计如下图:



(3)主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料,技术门槛较高。

产业链下游的半导体芯片制造通常采用不同工艺制程完成,不同的芯片制程工艺技术节点,对应于半导体硅片不同的纯度、晶体原生缺陷和杂质控制水平、硅片表面和边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等指标要求。下游芯片制程的技术节点越先进、对应的硅片上述指标控制越严格,不同的技术节点对应的指标控制参数会有相差。

正是由晶体生长和硅片加工过程中的超高精度要求,2018年以前全球只有前五大半导体硅片厂商掌握了300mm半导体硅片的单晶生长和硅片加工技术。

公司经过多年的持续研发和生产实践,目前已掌握了包含300mm半导体硅片在内的硅片生产的整套核心技术,包括单晶生长技术、切割技术、化学腐蚀技术、研磨技术、抛光技术、清洗技术、外延技术、SO技术与量测技术。

公司坚持紧跟国际前沿技术,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,技术水平和科技创新能力国内领先。但国内半导体硅片企业的研发与产品应用时间相对较短,在技术和市场方面正处于奋力追赶国际先进硅片厂商的进程之中。

2.　公司所处的行业地位分析及其变化情况

2016-2018年,全球半导体硅片行业集中度进一步提高,信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron五家企业市场份额从85%上升至93%,其中环球晶圆于2016年并购了原美国SunEdison Semiconductor、Ltd.和丹麦Topsil半导体硅片企业。

公司业务发展迅速、收入规模不断扩大,在全球半导体硅片市场份额持续提升。2016年至2018年,公司市场份额分别为0.53%、1.11%与1.26%,市场占有率逐步提高。2019年,公司实现销售收入约14.9亿元,比2018年增长约47.71%。SEMI预测2019年全球半导体硅片市场增长率为-3%,在此背景下,公司的市场占有率将进一步提高。

3.　报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期和未来一段时间,半导体硅片市场新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势如下:

(1)技术继续沿着“摩尔定律”和“超越摩尔”两条路径演进

依照摩尔定律,半导体行业呈现产品升级迭代快、性能持续提升、成本持续下降、制程不断缩小的基本发展趋势,制程的不断缩小提升了对半导体硅片的技术要求。

制程示称为节点或特征线宽,即晶体管栅极宽度的尺寸,用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。随着半导体制程的不断缩小,芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度不断降低。对应在半导体硅片的制造过程中,需要更加严格地控制硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标,这些参数将直接影响半导体产品的成品率和性能。

但同时,非数字、多元化的半导体技术与产品,如传感器等,可以在28nm及以上技术节点的成熟工艺生产线上制造,无需遵循摩尔定律继续缩小制程节点,即所谓“超越摩尔”。智能手机、智能穿戴设备、自动驾驶汽车等兴起后,基于“超越摩尔”技术的产品需求量越来越大。

“超越摩尔”定律的发展,使28nm及以上成熟技术节点能够获得更长的生命周期,提高半导体硅片在成熟技术节点上的使用数量和使用周期。

(2)未来较长的时间内,300mm仍将是半导体硅片的主流品种

随着半导体制程的不断缩小,芯片生产的工艺愈加复杂,生产成本不断提高,成本因素驱动硅片向着大尺寸的方向发展。半导体硅片尺寸越大,对于技术和设备的要求越高,半导体硅片的尺寸每进步一代,生产工艺的难度亦随之提升。目前更大尺寸的半导体硅片(如450mm)不具备更优成本效益,在中长期内,300mm半导体硅片仍将是半导体硅片的主流品种。

(3)半导体硅片市场将继续保持较高的集中度

半导体硅片行业技术壁垒高、资金壁垒高、人才壁垒高,并且与宏观经济关联性较强,半导体硅片企业需通过规模效应来提高盈利能力,预计未来半导体硅片市场仍将保持较高的集中度。

(4)中国大陆半导体硅片行业快速发展

近年来,中国政府高度重视半导体行业,制定了一系列政策推动中国大陆半导体行业的发展。2014年,国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》。受益于产业政策的支持、国内硅片企业技术水准的提升、以及全球芯片制造产能向中国大陆的转移,预计中国大陆半导体硅片企业的销售额将继续提升,将以高于全球半导体硅片市场的增速发展,市场份额占比也将持续扩大。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	9,963,244,097.36	6,822,546,904.24	46.03	5,833,376,480.35
营业收入	1,492,809,837.86	1,010,445,516.72	47.71	693,795,944.88
归属于上市公司股东的净利润	-89,914,508.46	11,205,736.81	-902.40	223,553,346.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-237,374,516.30	-103,333,075.78		-99,414,475.40
归属于上市公司股东的净资产	5,072,010,004.68	3,385,266,450.94	49.83	3,511,300,496.75
经营活动产生的现金流量净额	896,701,909.17	327,061,473.91	171.11	123,331,127.87
基本每股收益(元/股)	-0.050			
稀释每股收益(元/股)	-0.050			
加权平均净资产收益率(%)	-2.06			
研发投入占营业收入的比例(%)	5.64	8.29	减少2.65个百分点	

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	269,523,130.88	384,939,255.09	415,801,429.71	422,246,022.18
归属于上市公司股东的净利润	11,294,054.61	-86,262,720.65	28,460,408.22	-43,406,250.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,393,645.62	-97,454,816.44	-39,329,502.90	-80,196,551.34
经营活动产生的现金流量净额	-52,687,819.48	58,089,122.31	217,797,801.36	663,502,804.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海国盛(集团)有限公司		567,000,000	30.48	567,000,000	0	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司		567,000,000	30.48	567,000,000	0	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	12,272,600	174,272,600	9.37	174,272,600	0	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)		162,000,000	8.71	162,000,000	0	无	0	境内非国有法人
上海新微科技集团有限公司		162,000,000	8.71	162,000,000	0	无	0	国有法人
上海新阳半导体材料股份有限公司	139,653,500	139,653,500	7.51	139,653,500	0	无	0	境内非国有法人
建声实业有限公司	17,452,800	17,452,800	0.94	17,452,800	0	无	0	境外法人
宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙)	14,009,400	14,009,400	0.75	14,009,400	0	无	0	境内非国有法人
盈富泰克创业投资有限公司	12,272,600	12,272,600	0.66	12,272,600	0	无	0	境内非国有法人
GSI Creos Corporation	9,195,800	9,195,800	0.49	9,195,800	0	无	0	境外法人
以上股东持股变动情况报告期为2019年3月11日(股份公司成立日)至2019年12月31日。						未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		嘉定开发集团持有公司股东上海中科高科技工业园发展有限公司的90%股权,存在一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用√不适用

5　公司债券情况

□适用√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现营业收入149,250.98万元,同比增长47.71%,实现归属于上市公司股东净利润-8,991.45万元,较2018年下降10,112.02万元。

2　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),上海硅产业集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对上海硅产业集团无显著影响,其他修订对上海硅产业集团报表的影响见报告第十一节五财注(41)。

4　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

报告期间纳入合并范围的主要子公司详见财注八、附注九。

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2020-001

上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年4月27日,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向控股子公司上海新昇半导体科技有限公司(以下简称“上海新昇”)提供总额不超过人民币50,000万元借款专项用于实施“集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目”(以下简称“300mm硅片二期”),借款期限为自借款发放之日起6个月,同时采用市场利率收取利息。若在借款期限内,上海新昇成为公司全资子公司(以完成工商变更登记之日起,不予计息,转为无息借款,董事会授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]430号),公司于2020年4月首次公开发行A股620,068,200股,每股发行价3.89元人民币,募集资金总额为人民币2,412,065,298.00元,扣除发行费用人民币127,675,510.47元后,实际募集资金净额(下称“募资净额”)为人民币2,284,389,787.53元。上述募资资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2019)第0259号《验资报告》予以确认。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,本次募集资金主要用于“集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目”和“补充流动资金”,具体使用情况如下:

序号	募集资金使用项目	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目	217,251.00	175,000.00
2	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		292,251.00	250,000.00

三、使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的情况

(一)借款事项基本情况

公司首次公开发行股票的募投项目中“300mm硅片二期”的实施主体为公司控股子公司上海新昇。为了保障募投项目的顺利实施以及方便公司的管理,公司拟使用部分募集资金向上海新昇提供总额不超过人民币50,000万元借款专项用于实施“300mm硅片二期”,借款期限为自借款发放之日起6个月,同时采用市场利率收取利息。若在借款期限内,上海新昇成为公司全资子公司(以完成工商变更登记之日起,不予计息,转为无息借款。董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

2020年4月27日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的议案》。独立董事已发表了明确同意的意见。本次借款不构成关联交易或重大资产重组,无需提交股东大会审议。

(二)本次借款对象的基本情况

公司名称	上海新昇半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310115301484416G
成立时间	2014年06月04日
法定代表人	李炜
注册资本	人民币78,000.00万元整
公司住所	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	高品质半导体硅片研发、生产和销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	公司持股98.5%,上海新阳半导体材料股份有限公司持股1.5%
主要财务数据(未经审计)	截至2019年12月31日,上海新昇总资产为308,041.86万元,净资产为65,574.23万元;2019年实现净利润为-10,945.60万元。

四、本次提供借款对公司的影响

本次公司使用募集资金向上海新昇提供借款是基于募投项目建设需要,有利于推进募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向,有助于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

五、本次提供借款后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权利,上海新昇拟开立募集资金专项账户用于存放前述借款资金,董事会授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜,包括办理与开立募集资金账户,以及签署公司、上海新昇、保荐机构、监管银行等之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜,对本次所涉及的募集资金建立专户存储,确保募集资金使用的合法、有效。公司将在本次借款到位后按照上海证券交易所要求及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金管理制度》与上海新昇、保荐机构、银行及时签订四方监管协议。

公司及上海新昇将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定要求规范使用募集资金。

六、对使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目履行的审议程序

2020年4月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的议案》,为了保障募投项目的顺利实施,公司拟使用部分募集资金向上海新昇提供总额不超过人民币50,000万元借款专项用于实施“300mm硅片二期”项目,借款期限为自借款发放之日起6个月,同时采用市场利率收取利息。若在借款期限内,上海新昇成为公司全资子公司(以完成工商变更登记之日起,不予计息,转为无息借款。董事会授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

七、监事会、独立董事和保荐机构的意见

(一)监事会意见

监事会认为:本次公司使用部分募集资金向上海新昇提供借款是基于募投项目建设需要,有利于推进募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向,有助于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向控股子公司上海新昇提供总额不超过人民币50,000万元借款专项用于实施“300mm硅片二期”项目。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次公司将部分募集资金向上海新昇提供借款专项用于实施“300mm硅片二期”,不涉及原项目建设内容等情况的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,上述事项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,符合公司未来发展的需要和公司及全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施。同意公司使用部分募集资金向控股子公司上海新昇提供借款用于专项实施募投项目。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金向控股子公司上海新昇提供借款实施募投项目事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。该事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。因此,保荐机构对公司本次使用部分募集资金向控股子公司上海新昇提供借款实施募投项目的事项无异议。

八、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见

(二)　海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的核查意见

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2020-008

上海硅产业集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场及通信相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年4月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

监事会认为,由于公司2019年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况,符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,有利于维护公司全体股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此同意本次利润分配方案。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019　年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为,公司2019　年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司2019年年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于(公司与财务投资机关的内部控制自我评估报告(截至2019年12月31日))》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

6、审议通过《关于公司2020年度财务预算的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

(1)与Soitec的交易

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(2)与武汉新芯集成电路制造有限公司的交易

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(3)与长江存储科技有限责任公司有限公司的交易

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(4)与中芯国际及其关联公司的交易

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(5)与中国科学院上海微系统与信息技术研究所的交易

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(6)与上海新阳半导体材料股份有限公司的交易。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(7)与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司的交易。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(8)与上海国盛(集团)有限公司的交易

表决情况:2票赞成;0票弃权;0票反对;1票回避表决,关联监事杨路回避表决。

(9)与上海新微科技集团股份有限公司的交易

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

(10)与上海嘉定工业区开发(集团)有限公司的交易

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用额度不超过150,000万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的议案》。

监事会认为,本次公司使用部分募集资金向上海新昇提供借款是基于募投项目建设需要,有利于推进募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向,有助于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向控股子公司上海新昇提供总额不超过人民币50,000万元借款专项用于实施上海新昇的“集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目”。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分募集资金向上海新昇提供借款实施募投项目的公告》。

11、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度申请债务融资产品额度的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2020年度新增对外担保额度预计的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于2020年度新增对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2020-002

上海硅产业集团股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)总裁李晓忠先生因工作原因辞去总裁(即:总经理)职务,自2020年4月26日起正式生效。

未来,李晓忠先生将继续在公司任职,工作重心更聚焦于公司业务的发展。

后续,其将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定。公司也将持续披露其职位变动情况。

公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》,经董事会提名委员会审核,同意聘任Chiu Tzu-Yin(中文:邱慈云)先生为公司总裁(即:总经理),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

Chiu Tzu-Yin(中文:邱慈云)先生简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附:Chiu Tzu-Yin(中文:邱慈云)先生简历

男,出生于1956年4月,中国台湾人。加州大学伯克利分校电气工程博士,哥伦比亚大学高级管理人员工商管理硕士。曾获上海市“白玉兰荣誉奖”。

1996-2001年任台湾彩色电路制造股份有限公司运营高级总监;2001-2005年任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁;2006-2007年任华虹国际管理(上海)有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体(上海)有限公司总裁;2007-2009年任Silterra Malaysia总裁兼首席运营官;2009-2011年任华虹NEC电子有限公司总裁兼首席执行官;2011-2017年任中芯国际首席执行官兼执行董事和全球半导体联盟(GSA)董事;2019年5月起任上海新昇半导体科技有限公司总经理。目前,其还担任伯克利工程学院咨询委员、亚命利科技董事、上海和辉光电股份有限公司董事。

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2020-003

上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过150,000万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,海通证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金存放情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]430号),公司于2020年4月首次公开发行A股620,068,200股,每股发行价3.89元人民币,募集资金总额为人民币2,412,065,298.00元,扣除发行费用人民币127,675,510.47元后,实际募集资金净额(下称“募资净额”)为人民币2,284,389,787.53元。上述募资资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2020)第0303号《验资报告》予以确认。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2020年4月